



下一代 微型粘接解决方案

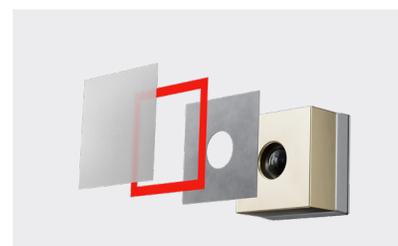
德莎提供面向未来设计的元器件胶粘解决方案，结合协同开发模式与经过验证的应用表现，支持客户应对当前生产需求，并为下一代产品开发提供技术支持。

面向未来的产品系列，适用于多种应用

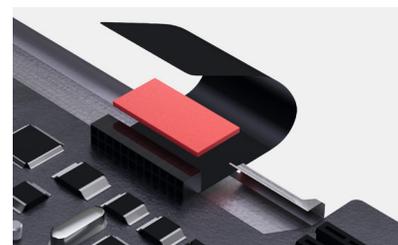
针对新一代电子元器件的设计需求，我们提供适配多种结构形式、材料组合、表面特性及应用场景的胶粘解决方案，涵盖**柔性线路板（FPC）**、**扬声器**、**传感器**及**摄像头模组**等新型结构设计。

德莎微型粘接解决方案一览

- 通用型PET胶带系列——采用抗反弹与高服帖性设计，适用于柔性线路板（FPC）或天线在曲面或弯折表面上的贴合，有助于防止产品翘起。
- 结构性粘接胶带系列——提供HAF、LTC、LTR系列胶带，在狭小粘接面积上实现稳定粘接强度。
- 无纺布胶带系列——具备耐高温性能，可适应柔性线路板（FPC）制造中的回流焊工艺条件。
- 导电胶带系列——不仅具备良好的导电性能，还具有较高的粘接强度。
- 可移除胶带系列——采用 Bond & Detach® 技术，支持重工操作，移除后无残胶，有助于保护元器件表面。



MEMS防水透声膜



FPC



扬声器



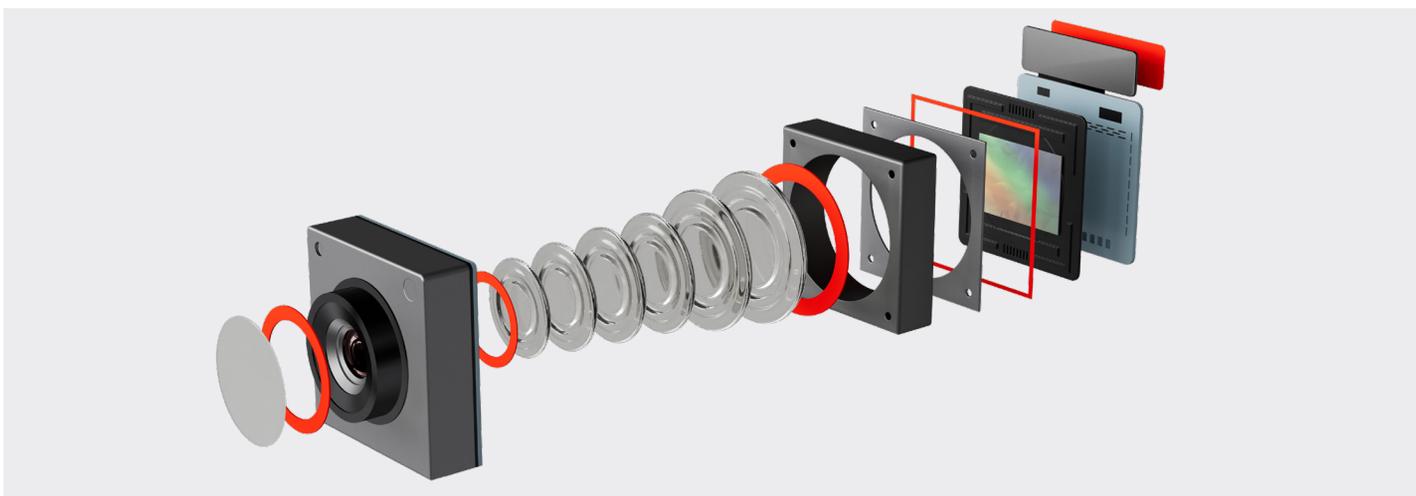
与您并肩同行的 全球合作伙伴

设计调整以适配本土生产流程

我们采用协同开发模式，可根据客户的工艺要求和设计特点，共同探讨定制化胶粘解决方案，满足微型结构设计中的粘接需求。

全球专业团队，现场技术支持

我们在全球设有本地技术团队，可以更快更主动地为客户提供现场支持、问题分析与故障排除。



摄像头

想要寻找合适的
解决方案？

德莎还有更多的产品选择。我们的专家可以根据您的要求，提供定制的解决方案。
欢迎通过邮件联系我们或者联系您的当地销售代表：tape.solution@tesa.com

德莎胶带（上海）有限公司
电话：+86 21 68183110
tesa.cn/industry/electronics

tesa.cn

德莎产品经过连续测试，在严苛条件下表现出卓越质量，并定期受到严格检测与控制。上述所有技术资料和数据都是基于实践经验提供。它们应被视为平均值，不适用于某一特定规格。因此，tesa SE不能作出任何明示或暗示的保证，包括但不限于任何针对特定用途的适销性或适用性的暗示保证。用户有责任确定德莎产品是否适合特定用途和用户的使用方法。如果您有任何疑问，我们的技术支持人员将很高兴为您服务。